

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-022

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**2026 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、本期业绩预告情况

### （一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

### （二）业绩预告情况

经合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：

1、预计公司 2026 年第一季度实现营业收入为 46,324.96 万元至 54,045.79 万元，与上年同期相比，同比增长 91.23%至 123.11%。

2、预计公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,604.39 万元至 12,371.78 万元，与上年同期相比，同比增加 104.45%至 138.53%。

3、预计公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 9,902.67 万元至 11,553.12 万元，与上年同期在相比，同比增加 91.96%至 123.95%。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

2025 年第一季度营业收入：24,224.31 万元。

2025 年第一季度归属于母公司所有者的净利润：5,186.68 万元。

2025 年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,158.73 万元。

## 三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩实现同比大幅增长，核心源于下游需求的持续走强与公司技术壁垒、产品矩阵及高效履约能力的多维共振：截至 2026 年 3 月末，公司 2026 年累计订单已突破 8 亿元，订单规模、增长势能与储备量均创同期新高。

在高端 PCB 赛道，AI 算力革命与汽车电子化浪潮推动高多层、高密度 PCB 需求激增，公司作为全球直写光刻设备龙头，高端 LDI 设备精准卡位行业升级需求，订单需求持续旺盛，产能利用率始终维持高位运行；泛半导体赛道，公司持续深化多赛道布局，直写光刻技术应用边界不断拓展，先进封装设备实现高速增长、IC 载板设备贡献稳健增量，掩膜版制版、显示业务多点开花，产品矩阵持续丰富，为长期增长筑牢根基；二期基地顺利投产叠加生产流程全面优化，交付能力与产能利用率大幅提升，高效保障订单快速落地；叠加国产替代趋势持续深化，公司在高端光刻设备领域的国产龙头地位持续巩固，多重核心利好共同驱动一季度业绩实现跨越式增长。

#### **四、风险提示**

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

#### **五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日